

認証書付属書（異板厚）

表1 認証試験板厚の溶接条件データ
 （最小及び最大ルート間隔の場合）

梁フラッグ板厚 (mm) × 通しダイアフラム 板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
12 × 19	3.0	4～10テーパ	250～330	29～36	24～30	4
		10	250～330	29～36	24～30	
32 × 45	9.0	4～10テーパ	270～360	30～37	19～35	12
		10	270～360	30～37	19～35	

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（表面段差 ≤ 2.0mm）

梁フラッグ板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小 6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	2.0以下	4	230～350	25～39	20～40	2
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
12	2.0以下	4	230～350	25～39	20～40	3
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
16	2.0以下	4	240～360	25～41	20～55	4
		6	240～360	25～41	15～50	
		10	240～360	25～41	15～40	
19	2.0以下	4	240～380	25～41	20～55	5
		6	240～380	25～41	15～50	
		10	240～380	25～41	15～40	
22	2.0以下	4	240～400	25～42	20～55	5
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
25	2.0以下	4	240～400	25～42	20～55	7
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
28	2.0以下	4	240～400	25～42	20～55	8
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
32	2.0以下	4	240～400	25～42	20～55	10
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
36	2.0以下	4	240～400	25～42	20～55	13
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
40	2.0以下	4	240～400	25～42	20～55	15
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める（少数点以下は切上げ）。

※ この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは4.0mmを標準とする。

※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降

表3 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲 (2.0mm < 表面段差 ≤ 5.0mm)

梁フラット板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小 6 mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	3.0以下	4	230~350	25~39	20~40	3
		6	230~350	25~39	15~35	
		10	230~350	25~39	15~30	
12	3.0以下	4	230~350	25~39	20~40	4
		6	230~350	25~39	15~35	
		10	230~350	25~39	15~30	
16	5.0以下	4	240~360	25~41	20~55	5
		6	240~360	25~41	15~50	
		10	240~360	25~41	15~40	
19	5.0以下	4	240~380	25~41	20~55	5
		6	240~380	25~41	15~50	
		10	240~380	25~41	15~40	
22	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	6
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
25	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	8
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
28	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	9
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
32	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	11
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
36	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	13
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
40	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	15
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める（少数点以下は切上げ）。

※ この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは4.0mmを標準とする。

※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降

表4 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲 (5.0mm < 表面段差)

梁フラット板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小 6mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	3.0以下	4	230~350	25~39	20~40	3
		6	230~350	25~39	15~35	
		10	230~350	25~39	15~30	
12	3.0以下	4	230~350	25~39	20~40	4
		6	230~350	25~39	15~35	
		10	230~350	25~39	15~30	
16	5.0以下	4	240~360	25~41	20~55	5
		6	240~360	25~41	15~50	
		10	240~360	25~41	15~40	
19	5.0以下	4	240~380	25~41	20~55	5
		6	240~380	25~41	15~50	
		10	240~380	25~41	15~40	
22	6.0以下	4	240~400	25~42	20~55	8
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
25	7.0以下	4	240~400	25~42	20~55	10
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
28	8.0以下	4	240~400	25~42	20~55	10
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
32	9.0以下	4	240~400	25~42	20~55	12
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
36	10.0以下	4	240~400	25~42	20~55	14
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	
40	11.0以下	4	240~400	25~42	20~55	16
		6	240~400	25~42	15~50	
		10	240~400	25~42	15~40	

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める（少数点以下は切上げ）。

※ この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは4.0mmを標準とする。

※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降